



高端数控光学制造装备

化学机械抛光单模组

基于晶圆的抛光设备，利用柔性抛光头承载晶圆在抛光垫上旋转抛光。设备具有高度兼容性，可以通过修改 RECIPE 变更加压压力，可通过最多 3 种化学液的配合下实现化学机械抛光。

优势：

1. 具备气囊背压功能，可兼容多区加压抛光头；
2. 灵活 RECIPE 设定，高质量的 SFQR 和 ESFQR；
3. 可兼容 6 或 8 寸抛光头，便捷更换式抛光盘；
4. 可使用摩擦力终点检测或光学终点检测功能；
5. 3 路独立供液管路；
6. 占地面积小；



主要技术指标

主要参数	型号
晶圆尺寸	Φ 508mm (20Inch)
抛光盘转速	0-200RPM
抛光头转速	0-120RPM
WAFER 压力	5-500G/CM ² (气囊柔性加压)
修整器	摆臂式修整系统
终点检测	可增选 EPD 功能
供液	3 路独立化学液管路

